



**(0,50mm) .01969"**  
**BTH, BSH 系列**

# 基础端子条和插座条

**技术规格**

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 [www.samtec.com?BTH](http://www.samtec.com?BTH) 或 [www.samtec.com?BSH](http://www.samtec.com?BSH)

绝缘体材料:  
 液晶聚合物  
 触点材料:  
 磷铜  
 电镀:  
 在 50µ" (1,27µm) 的镍上镀金或锡  
 额定电流:  
 1.25A @ 80°C 环境  
 可燃性等级:  
 UL 94 VO  
 工作温度范围:  
 -55°C 至 +125°C  
 额定电压:  
 125 VAC  
 最大循环数:  
 100  
 符合 RoHS 规范要求:  
 是

加工:  
 无铅可软焊性:  
 是

SMT 引线共面度:  
 最大 (0,10mm) .004" (030-090)  
 最大 (0,15mm) .006" (120-150)  
 电路板相叠:  
 对于每板或不少于 90 个位置需要超过两个连接器的应用, 请发邮件至 [ipg@samtec.com](mailto:ipg@samtec.com)



**BTH** — **每排位置数** — **01** — **电镀选项** — **D** — **A** — **其他选项**

配接: BSH

**-030, -050, -060, -090, -120, -150**

**-F**  
= 触点闪镀金, 尾端镀雾锡

**-L**  
= 10µ" (0,25µm) 触点镀金, 尾端镀雾锡

**-C\***  
= 选择性电抛光 触点区信号针脚的 150µ" (3,81µm) 镍底上至少 50µ" (1,27µm) 镀金, 触点区接地面 50µ" (1,27µm) 的镍底上至少 10µ" (0,25µm) 镀金, 所有焊接尾端至少 50µ" (1,27µm) 的镍底上镀雾锡

**-K**  
= (7,00mm) 0.276" 直径聚酰亚胺薄膜取放垫

**-TR**  
= 卷带封装 (最多 120 个位置)



**堆叠高度**

引线式样	堆叠高度*
-01	(5,00) .197

\*加工条件将影响配接高度。

**BSH** — **每排位置数** — **01** — **电镀选项** — **D** — **A** — **其他选项**

配接: BTH

**-030, -050, -060, -090, -120, -150**

**-F**  
= 触点闪镀金, 尾端镀雾锡

**-L**  
= 10µ" (0,25µm) 触点镀金, 尾端镀雾锡

**-C\***  
= 选择性电抛光 触点区信号针脚的 150µ" (3,81µm) 的镍底上至少 50µ" (1,27µm) 镀金, 触点区接地面 50µ" (1,27µm) 的镍底上至少 10µ" (0,25µm) 镀金, 所有焊接尾端至少 50µ" (1,27µm) 的镍底上镀雾锡

**-TR**  
= 卷带封装 (最多 120 个位置)

**特殊应用选项**

- 30µ" (0,76µm) 镀金
- 边缘封装能力
- 8mm、11mm、16mm、19mm 和 22mm 堆叠高度 (注意: 有些自动置放/检验设备可能对组件高度有限制。请参考设备规范。)(11mm、16mm、19mm 和 22mm 不适用于 50 个位置)。

请致电 Samtec。

\*注: -C 电镀已通过十年 MFG 测试  
 注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

**AGILENT 逻辑分析器测试点连接器**  
 指定: ASP-65067-01